

平成27年度 ナノテクキャリアアップアライアンス  
京都大学 電子線描画装置入門コース《短期型》

■目的、対象者：

最先端の半導体やMEMS デバイスにおいて、微細な配線や構造が必要となってきました。これらの微細配線や構造を作製するためのキー技術となっているのが、nm オーダの微細パターンを描画できる電子線描画装置です。

本コースにおいては、微細加工の初心者を対象にし、CAD による描画パターン設計、最新鋭電子線描画装置による Si ウェハ（酸化膜付）の描画（露光）、ドライエッチング装置による微細加工、SEM による加工した微細構造観察 を行い微細加工の基本技術習得を目指します。

■募集人数： 5名（最大）

■期間： 平成27年8月3日（月）～8月12日（水）

講義：2日間（全員）、実習：2日間（個別） 合計4日間

■会場： 京都大学ナノテクノロジーハブ拠点

■内容：

1日目、2日目 8月3日（月）、4日（火）

① 電子線描画の基礎（講義） 参加者全員が対象

\*）以下の日程は受講者毎に連続した2日間で実施します。参加者により日程が異なりますのでご注意ください。具体的な受講日程は、受講決定後、調整します。

3日目 8月5日（水）or 6日（木）or 7日（金）or 10日（月）or 11日（火）

② CAD によるパターン設計（実習）

③ スピンコータによるレジスト塗布（実習）

④ 電子線描画装置による描画（実習）

4日目 8月6日（木）or 7日（金）or 10日（月）or 11日（火）or 12日（水）

⑤ 描画パターンの現像（実習）

⑥ 酸化膜のドライエッチング加工（実習）

⑦ 加工構造のSEM 観察（実習）

⑧ レポート作成

■受講料：

アライアンス内の博士課程（後期）学生、若手研究者および研究支援人材：  
無料（旅費の補助を予定）

一般：250,000円

■連絡先： 京都大学ナノテクノロジーハブ拠点

(kyodai-hub@saci.kyoto-u.ac.jp、電話：075-753-5231)